

MES 2008 プログラム			9月18日(木)	
	A 室	B 室	C 室	D 室
10:30	【1A1】回路基板 I —基板プロセス— 座長：天明浩之（日立製作所） 1. 次世代パッケージ用アディティブブリブ レグ ○渡辺朋亮，山口真魚，武田 剛，藤原 弘明，吉岡慎悟（松下電工） 2. 可溶性 LCP を用いた低熱膨張・低吸湿 膨張ガラスクロスブリブレグの開発 ○沈 昌楠，高橋奈央，阿部 武，伊藤 豊誠，岡本 敏（住友化学） 3. 発表中止 4. ダイレクトメタライゼーション法を用い たフレキシブル基板プロセスの開発 ○小川特志，森田芳郎，村山里奈，今瀧 智雄，松原浩司（シャープ），縄寿秀美 （甲南大学）	【1B1】半導体チップ実装 I 座長：伊達仁昭（富士通研究所） 1. 基板内で分岐・屈曲した3次元貫通配 線の作製と評価 ○脇岡寛之，橋本廣和，末益龍夫，山本 敏，額賀 理（フジクラ） 2. 貫通電極形成歩留り改善技術の開発 ○川下道宏，吉村保廣，田中直敏（日立 製作所），下川敏子，木下順弘，植松俊 英，藤澤雅彦，内藤孝洋，赤沢 隆（ル ネサステクノロジ） 3. Au 薄膜を介した Cu 電極の微細ピッチ CoC 実装技術開発 ○難波兼二，田子雅基（日本電気），栗 田洋一郎，副島康志，川野連也（NEC エレクトロニクス），菊池 克，山道新 太郎，村上朝夫（日本電気） 4. 無電解めっき法により作製したフリップ チップ接続用微細 Au バンプの評価 ○野村建太郎（東京理科大学，産業技術 総合研究所），横島時彦，山地泰弘，菊 地克弥，仲川 博（産業技術総合研究 所），越地耕二（東京理科大学），青柳昌 宏（東京理科大学，産業技術総合研究 所），岩井良太，加藤 勝（関東化学）	【1C1】基板材料技術 座長：上西啓介（大阪大学） 1. 環境に配慮した高耐熱ソルダーレジスト の開発 ○星野政人（ハンツマンアドバンスマテ リアル） 2. 極薄プリント配線板用材料の開発動向 ○吉川真士（旭化成エレクトロニクス） 3. 銅粒子を内部電極材料とした MLCC の 作成 ○米澤 徹（東京大学），竹岡伸介，岸 弘志（太陽誘電），井田清信，友成雅則 （石原産業） 4. 高密度実装用薄膜コンデンサの開発 ○小川裕裕，王 樹強，尾関晴幸，張 維，服部篤典（野田スクリーン）	【1D1】めっき技術 座長：藤原 裕（大阪市立工業研究所） 1. ポリイミドフィルム上無電解 Cu-Ni めっき皮膜のピール強度におよぼす加熱 処理の影響 ○村上朋央，木村美緒，青木祐行，西城 信吾（奥野製薬工業），濱澤晃久，井口 文明，土屋薫（荒川化学） 2. W-CSP のビアフィリングの基礎的検討 ○本間景虎，和久田陽平，金森元氣，小 岩一郎（関東学院大学），藤崎純史，八 重樫良平，田村俊夫（野毛電気工業） 3. Cu 上の直接無電解 Pd めっきプロセス ○工藤喜美子，下地輝明，松浪卓史（奥 野製薬工業），縄寿秀美（甲南大学） 4. 高精細配線対応無電解 Ni/Pd/Au めっ き技術 ○江尻芳則，畠山修一，有家茂晴，櫻井 健久，川上裕，西田典弘，長谷川清（日 立化成工業）
11:50	昼休み			
12:50	【1A2】回路基板 II —表面処理— 座長：馬場和宏（日本電気） 1. ダイレクトレーザー加工法におけるビア 底エッチングとテスミア代替プロセスに ついて 中村幸子，○池尻篤泰（メック） 2. スプレーを用いた水溶性ブリフラックス 処理方法の検討 ○西江健二，古川良昭，矢熊紀子（メッ ク） 3. 黒化処理による Cu ダイレクトビア加工 の検討 ○川村利則，赤星晴夫（日立製作所）， 荒井邦夫（日立ビアメカニクス） 4. プラズマ処理による DAF を用いたダイ アタッチプロセスの信頼性向上 ○古川良太，笹栗真二（パナソニック ファクトリーソリューションズ）	【1B2】半導体チップ実装 II 座長：頼 明昭（シャープ） 1. 無電解めっき法によるケミカルフリップ チップボンディング (I)―微細電極接続 の基礎評価― ○横島時彦，山地泰弘，井川 登，田村 裕一郎，菊地克弥，仲川 博，青柳昌宏 （産業技術総合研究所） 2. 無電解めっき法によるケミカルフリップ チップボンディング (II)―微細ピッチ・ フェースダウン接続への展開― ○山地泰弘，横島時彦，井川 登，田村 裕一郎，菊地克弥，仲川 博，青柳昌宏 （産業技術総合研究所） 3. 水素ラジカルを用いたフラックスレスは んだバンプ接続技術 ○大野恭秀（東京大学生産技術研究所）， 末永 誠（ソニーセミコンダクタ九州）， 吉田真悟（ローム），谷口慶輔（NEC セ ミコンダクターズ九州・山口），竹内達 也，萩原泰三（神港精機） 4. 水素ラジカル照射によるはんだ再酸化抑 制効果 ○萩原泰三，竹内達也（神港精機），大 野恭秀（東京大学）	【1C2】実装材料・技術 座長：友景 肇（福岡大学） 1. 一括リフロー可能な部分補強材の開発～ PoP の検討 ○吉永誠一，和田義之，境 忠彦，酒見 省二（パナソニック ファクトリーソ リューションズ） 2. 中空封止可能なシート状エポキシ封止材 料 ○橋本卓幸（ナガセケムテックス），西 沢正登（長瀬産業），西川雄基（ナガセ ケムテックス，長瀬産業） 3. プラズマを用いたポリイミドの表面処理 に関する研究 ○倉橋孝宏（ニッシン） 4. 無酸素・無水分包装による電子部品の保 存とデラミネーション防止及び接続信頼 性維持効果 阪本 勝，増田章宏（三菱ガス化学）	【1D2】環境・環境対応評価 座長：佐藤武彦（大阪大学） 1. Zn-Sn 系高温鉛フリーはんだのダイア タッチ適合特性 ○金 声俊，金 権株，金 善植，菅沼 克昭（大阪大学） 2. Sn ウィスカ防止用表面ナノめっきの信 頼性評価 ○金 権株，金 金善植，菅沼克昭（大 阪大学），辻本雅宣，梁田 勇（上村工 業） 3. Sn の同素変態を用いたはんだ接合部の 分離に関する基礎検討 ○藤巻 礼，荻谷義治（芝浦工業大学）， 須賀唯知（東京大学） 4. 樹脂材料中に難燃剤として添加された赤 リンの分析法 ○飯田益大，宮武健一郎，飯原順次，木 村 淳（住友電気工業）
14:10				

	百周年記念ホール	【セッション会場】 A 室：313 号室 B 室：315 号室 C 室：216 号室 D 室：312 号室 【カタログ展示コーナ】 ゼミ室
14:30	MES 2007 表彰式	
14:45		
14:50	招待講演 座長：池田 徹（MES2008 組織委員長，京都大学） 1. MEMS とナノテクノロジーのシームレス融合技術 ―実装技術への期待と可能性―（仮題） 田畑 修（京都大学大学院工学研究科教授） 2. 半導体 IC と実装基板の融合に向けて―高密度・高性能実装技術の進むべき方向― 本多 進（NPO 法人サーキットネットワーク理事）	
16:50		

17:20	交流会 会 場：京大吉田生協 参加費：4,000 円（消費税込み） *MES*参加費には含まれておりません。
19:00	

MES 2008 プログラム			9月19日(金)	
	A 室	B 室	C 室	D 室
9:45	【2A1】回路基板 III —微細パターン— 座長：大塚邦顕（奥野製薬工業） 1. LTCC グリーンシートにおける段差のない微細導体パターンの形成方法 ○赤木陽介，太田直登，浦田健一，内木場文男（日本大学） 2. UV 照射を利用するガラス基板上への銅のダイレクトパターンニング ○中道良太，赤松謙祐，縄舟秀美（甲南大学） 3. 自己組織化膜 SAMs のマイクロコンタクトプリンティングを利用した銅タマシンプロセス ○中嶋勝之，赤松謙祐，縄舟秀美（甲南大学）	【2B1】半導体チップ実装 III 座長：菅沼克昭（大阪大学） 1. 超音波接合による Au/Ag 接合部の結晶組織観察 ○十川三臣（九州工業大学） 2. ガステポジション法による円錐パンプの作製 ○居村史人，仲川 博，菊地克弥，山地泰弘，横島時彦，馬場 創，明渡 純，青柳昌宏（産業技術総合研究所） 3. チップレベル LSI テストに向けた微細コンタクトパンプ形成技術の開発 ○鈴木基史，横島時彦，井川 登，岡田義邦，仲川 博，青柳昌宏（産業技術総合研究所），三浦政敏，高橋 剛，北山公也，江藤篤志，姫野智浩，丸井 彰（STK テクノロジー） 4. SiP の反りとアンダーフィル材料が実装性・信頼性に与える影響について ○乃万裕一，鳥山和重，折井靖光（日本アイ・ビー・エム）	【2C1】評価とシミュレーション I —はんだ材料— 座長：春田 亮（ルネサステクノロジ） 1. Sn-Ag-Cu はんだ接合部の疲労寿命予測におよぼす非弾性構成式の影響 ○座間邦宏，神田喜彦，菊谷義治（芝浦工業大学） 2. はんだ接合部のリフロープロセスシミュレーションの開発とばらつき検証への応用 ○高木寛二（横浜国立大学，オムロン），千 強，澁谷忠弘，宮内裕樹（横浜国立大学） 3. 流体と構造体との強連成解析によるはんだパンプ変形挙動の究明 平田一郎（日本電気） 4. 応力-拡散解析を用いた温度サイクル中の錫ウィスカの成長性評価 ○寺崎 健，大倉康孝，岩崎富生，加藤隆彦，中村真人（日立製作所），橋本知明（ルネサステクノロジ）	【2D1】光モジュール 座長：齊藤雅之（東芝） 1. 樹脂製光アウトレットを内蔵した新チップ VCSEL の提案と試作 ○神田昌宏，小川知訓，三上 修（東海大学） 2. 光インターフェース用超小型光モジュールの開発 ○小田三紀雄，小野秀之，大塚 隆，堺淳，高橋久弥，古宇田 光（日本電気），是枝雄一（日本航空電子工業） 3. 異方導電性フィルムコネクタを用いた筐体内信号伝送のための小型・高速光モジュール ○鈴木 敦（産業技術総合研究所，日本特殊陶業），若園芳嗣，石川隆朗，橋本陽一，増田 宏，鈴木修司，田村充章，鈴木貞一，菊地克弥，仲川 博，青柳昌宏，三川 孝（産業技術総合研究所） 4. 筐体内 CWDM 伝送に向けた光電気実装技術の検討 ○若園芳嗣，鈴木 敦，石川隆朗，橋本陽一，増田 宏，鈴木修司，田村充章，鈴木貞一，菊地克弥，仲川 博，青柳昌宏，三川 孝（産業技術総合研究所）
11:05	休憩			
11:15	【2A2】ナノ粒子/MEMS 座長：赤松謙祐（甲南大学） 1. 銅ナノ粒子および銀-銅二元金属ナノ粒子を用いた配線形成と接合プロセス 長岡 亨，森貞好昭，福岡真男，柏木行康，山本真理，○中許昌美（大阪市立工業研究所），垣内宏之，松村慎亮，吉田幸雄（大研化学工業） 2. 常温焼結 Ag 粒子ペーストの性質と常温接合の検討 ○和久田大介，金 権鉄，菅沼克昭（大阪大学） 3. Ag ナノ粒子によるフリップチップ接合技術の開発 ○舟木達弥，前田剛伸，清野純弥，小幡孝義，大竹健介，高見和憲，堀 良嗣，弘田実保（村田製作所） 4. 静電発電機構を有するマイクロエアービンの作製 ○大森陽介，茶園達也，内木場文男（日本大学）	【2B2】鉛フリーはんだ 座長：竹本 正（大阪大学） 1. Sn-Bi 共晶はんだへの第三元素添加効果 ○金児仁史，鳥居久範，上西啓介，佐藤武彦（大阪大学），赤松俊也，作山誠樹（富士通研究所） 2. Sn の sub-grain の形成に及ぼす添加元素の影響 ○高木広和，山内 啓，黒川一哉，田中順一（北海道大学），入澤 淳，川久保聡（弘輝） 3. 化学的還元法による狭ピッチパンプ形成用はんだ微粉末の開発 ○宇野浩規，村岡弘樹，久芳完治（三菱マテリアル） 4. 鉄基合金の溶食挙動に及ぼす合金元素の影響 ○山内 啓，黒川一哉，田中順一（北海道大学），川久保 聡，入澤 淳（弘輝）	【2C2】評価とシミュレーション II —プリント基板— 座長：井上博文（日本電気） 1. プリント配線板におけるガラス繊維と樹脂の積層構造を考慮した IVH (Interstitial Via Hole) の熱疲労解析 ○竹中国浩，下地正一郎（安川電機），千 強，松本 翼（横浜国立大学） 2. プリント基板の数値解析におけるモデリング技術 ○久保田哲行，伊東伸孝（富士通アドバンストテクノロジー） 3. カバーレイコート2層銅張積層板を用いたフレキシブル配線板に対する交流インピーダンス法による電氣的信頼性評価—ワールブルグインピーダンスに関する解析 吉原佐知雄（宇都宮大学） 4. プリント配線板の耐湿性における寿命予測法の検討 中村和裕（新光電気工業）	【2D2】LED パッケージ 座長：森 三樹（東芝） 1. 近紫外励起超弾白色 LED (1) ○片岡忠温，大城悟司，榊原靖彦，内田裕士，倉井 聡，加藤一久，田口常正（山口大学） 2. 近紫外励起超弾白色 LED (2) ○大城悟司，片岡忠温，榊原靖彦，内田裕士，倉井 聡，加藤一久，田口常正（山口大学） 3. 直接フリップチップ接合を用いた蛍光体変換型 LED の発光効率の実装密度依存性 ○加門邦人，林 秀樹，福井 剛，宮地努，内田裕士，倉井 聡，田口常正（山口大学） 4. 近紫外 LED の光取り出し効率のパッケージ形状依存性 ○林 秀樹，加門邦人，福井 剛，宮地努，内田裕士，倉井 聡，田口常正（山口大学）
12:35	昼休み			
13:35	【2A3】MEMS 座長：新井 進（信州大学） 1. トレンチ内へのニッケルめっき膜の作製 ○安宅一泰，岡本尚樹，齊藤文靖，近藤和夫（大阪府立大学） 2. Ni-Co 合金の微小構造物の作製 ○山田雅士，岡本尚樹，齊藤文靖，近藤和夫（大阪府立大学） 3. MEMS プローブと Au および Al 電極との接触性評価 ○牧野友貴治，松本卓也，上西啓介，佐藤武彦（大阪大学），石田友弘，坂本哲尚，木村哲平，田島章平，(JEM ファインテック) 4. 微小荷重における電気接点現象の評価 ○オマールモクタル，金田弘幸，小澤佑介，上西啓介，佐藤武彦（大阪大学）	【2B3】三次元実装 座長：西田秀行（ニジエレクトロニクス技術開発） 1. アルミ電極を有する SiC パワー素子の高温三次元実装技術 ○郎 豊群，林 祐輔，仲川 博，青柳昌宏，大橋弘通（産業技術総合研究所） 2. フレキシブル配線基板を用いた超小型 3 次元パッケージング技術 ○渡辺真司，山崎隆雄（日本電気），菊池昌司（東北日本電気），村上朝夫（日本電気） 3. 三次元フリップチップ実装構造における低残留応力実装構造の提案 ○上田啓貴，佐々木拓也，三浦英生（東北大学） 4. マイクロスケールストレインセンサを用いたトランジスタ残留応力の評価 ○佐々木拓也，上田啓貴，三浦英生（東北大学）	【2C3】評価とシミュレーション III —計測技術— 座長：千 強（横浜国立大学） 1. 静電容量型プローブを用いた微小パターン検査に関する研究 ○野口祐智，斎藤之男，角田興俊（東京電機大学） 2. デジタル画像相関法を用いたレーザー顕微鏡観察による回路基板内部のひずみ分布計測 ○矢野信之，池田 徹，宮崎則幸（京都大学） 3. MZ 型光導波路を用いた AE 検出システムの検討 ○野村 亮，吉川隼人，水澤純一（青山学院大学） 4. 放射光 X 線マイクロ CT による 3 次元データを用いたフリップチップはんだ接合部のき裂進展過程の評価 ○釣谷浩之，佐山利彦（富山県工業技術センター），岡本佳之，高柳 毅（コーセル），上杉健太郎（高輝度光科学研究センター），森 孝男（富山県立大学）	【2D3】高速・高周波設計 座長：和田修己（京都大学） 1. コックピットハーネス新構造と EMI 解析 ○岡崎文洋（カルソニックカンセイ），クライソン・トロンナムチャイ，大村一世，泰賢太郎（日産自動車），小笠原武，安在岳志（カルソニックカンセイ） 2. 部品内蔵基板における EMI 効果の検討 ○三浦雅広，島田 諭，宮崎 誠，初澤健二，花岡仁登，松田 徹（長野沖電気），小池 清，高山勝之（沖プリンテッドサーキット） 3. 電源用低インピーダンス伝送線路の開発 ○橋本 薫，秋山 豊，大塚寛治（明星大学），川口利行，田原和時（信越ポリマー） 4. フレキシブルプリント配線板における軽量化と高速伝送対応技術 ○室生代美（東芝） 5. フレキシブルプリント基板における屈曲時の高周波特性評価 ○田中壮宗，本上 満（日東電工）
14:55	休憩			
15:05	【2A4】導電性接着剤 座長：江岡富世（バイソニックパイルコミュニケーションズ） 1. 金属結合型導電性接着剤の開発 金 宏樹，今野 馨，川守崇司，田中俊明（日立化成工業） 2. 耐酸化性に優れた銅粒子含有導電性接着剤の検討 ホ リニ，西川 宏，竹本 正，夏目直英（大阪大学），三宅行一，藤田政和（三井金属鉱業），織田晃祐（神岡鉱業） 3. 導電性接着剤の耐湿性評価 ○平田拓哉，中川泰利，田中浩和（エスベック）	【2B4】CSP 信頼性向上 座長：田畑晴夫（ローム） 1. 低弾性率配線基板に対する CSP の実装信頼性 ○阿部勝巳，藤井健一郎，小勝俊亘（日本電気） 2. エキシマレーザによるビア加工を用いた W-CSP の検討 ○八重樫良平，山田忠明，田村俊夫，藤崎純史（野毛電気工業），和久田陽平（野毛電気工業，関東学院大学），小岩一郎（関東学院大学） 3. CAE と DoE（実験計画法）を活用した WL-CSP Cu ポスト構造評価 ○門口卓史，山中政彦，戸田敏二（トヨタ自動車）	【2C4】評価とシミュレーション IV 座長：福岡義孝（ウェイスティ） 1. 電気-熱-構造連成解析を用いたパワーデバイスの劣化における評価と信頼性解析 ○安澤貴志，千 強，澁谷忠弘，白鳥正樹（横浜国立大学），山際正憲（横浜国立大学，日産自動車） 2. 有限要素法応力解析とデバイスシミュレーションによる実装応力に起因した nMOSFET の DC 特性変動評価 ○小金丸正明（福岡県工業技術センター），池田 徹，小森正輝，宮崎則幸（京都大学），友景 肇（福岡大学） 3. フリップチップ接合半導体パッケージの信頼性解析 (II) ○田中宏之，畑尾卓也，沼田 孝（住友ベークライト） 4. 樹脂とシリコンの微細界面構造を考慮したはく離強度評価手法の開発 ○松本 翼，千 強，澁谷忠弘（横浜国立大学），松崎富夫（カシオ計算機）	(15:10)
16:25				